

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

美芯晟科技（北京）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称	广发基金管理有限公司；华创证券有限责任公司；民生证券股份有限公司；太平养老保险股份有限公司；西部利得基金管理有限公司；兴证全球基金管理有限公司；中国人寿养老保险股份有限公司；
时间	2024年1月24日-26日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘雁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司无线充电产品目前主要覆盖了哪些终端品牌客户？</p> <p>凭借较强的技术实力、可靠的产品质量和快速有效的客户服务，公司无线充电产品已进入众多主流智能终端厂商的供应链体系，应用终端覆盖通信终端、消费类电子等领域，终端产品覆盖了品牌 A、传音、荣耀、三星、小米、联想、惠普等知名品牌。</p> <p>2、公司计划如何保持无线充电领域的竞争优势？</p> <p>随着无线充电应用的普及以及车载无线充电应用场景建立，无线充电市场呈现持续增长态势，公司计划从以下方面保持竞争优势：1) 持续拓展终端客户群，扩大双方合作范围与深度，针对不同的客户需求提供细化的定制服务，以此提升客户粘性和壁垒；2) 优化产品设计，加速产品迭代，保持在技术和创新方面的领先，为客户提供全面且具备高性价比的解决方案；3) 优化原有生产工艺，并加强自身工艺研发能力；4) 率先推出满足工信部最大功率规定的 80W 接收端芯片。</p>

3、公司在晶圆、封测等环节主要与哪些上游厂商有所合作？

供应链是保障半导体及集成电路设计公司稳定发展的重要环节，公司基于自主研发的技术体系及工艺开发平台的能力拓展，与华虹宏力、台积电、燕东微电子、中芯国际等主要晶圆厂家，以及气派科技、晶导微电、华天科技等封测厂进行广泛的业务合作与战略协同，实现了产品设计与生产工艺的深度融合与优化，巩固了公司稳定的供应链渠道优势。

其中，公司与上游供应商紧密合作，完成了 700V-BCD 高压集成工艺及 100V-BCD 器件工艺的开发，并且积极研发推进针对 12 寸晶圆的 90nm 40V-BCD 工艺，以此提升产品性能、功能及性价比，进一步提升产品竞争力。

4、公司如何展望信号链业务的发展？

公司在信号链领域布局的产品可广泛应用于消费类电子和汽车电子领域，涵盖环境光和接近传感器、光学入耳检测传感器、光学表冠传感器、车载应用的雨量和雾气检测传感器等多种产品。其中，以光学表冠传感器、接近传感器、窄缝三合一等为代表的产品整体进展顺利，客户端验证反馈较好，目前已实现量产出货，具体产品销售业绩等数据请以定期报告披露数据为准。

未来，公司也将进一步拓展信号链业务下游应用领域及使用场景，逐步完善全屏下、多光谱、TOF 等光传感产品的布局，将信号链光传感业务打造为公司业绩的第三增长曲线。

5、公司汽车电子产品中 CAN SBC 目前的进展？

CAN SBC 芯片是面向车规级应用的系统基础芯片，集成 CAN FD 收发器、PMIC、失效安全模式等功能模块，满足高集成度、高可靠性、高安全性、低功耗的 CAN 通讯及电源管理整体解决方案的应用需求，属于汽车电子中相对复杂的芯片之一，目前 CAN SBC 芯片市场主要由海外厂家主导，市场具备广阔的国产替代空间。公司与新势力车企合作开发的 CAN SBC 芯片已实现流片，后续将逐渐启动相关的车规认证，整体进展顺利。

6、公司目前订单情况如何？

公司在手订单充足，产品线均处于有序生产、备货及供货的状态，公司按照既定的生产经营计划稳步推进工作，基本面良好。

	公司积极推进无线充电、信号链光传感、LED、汽车电子等领域的产品研发、布局及客户资源拓展，努力通过优秀经营业绩体现公司的投资价值，具体经营数据请以披露的定期报告为准。
附件清单(如有)	无
日期	2024年1月30日